Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ)

Институт прикладной математики и информатики био- и нанотехнологий **Кафедра** физики и прикладной математики

> Герке Мирон Николаевич Кучерик Алексей Олегович

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине «Системы лазерной полупроводниковой накачки» для студентов ВлГУ, обучающихся по направлениям 200500.62 (12.03.05) «Лазерная техника и лазерные технологии», 200500.68 (12.04.05) «Лазерная техника и лазерные технологии» 200400.68 (12.04.02) «Оптотехника»

ВВЕДЕНИЕ	3
ТЕМА 1. Оптическая накачка – основной тип накачки твердотельных лазерных сред	5
ТЕМА 2. Физические основы функционирования полупроводниковых лазо	еров
	6
ТЕМА 3. Конструкции мощных лазерных диодов	7
ТЕМА 4. Многоэлементные полупроводниковые излучатели – линейки и	
матрицы ЛД	8
Теоретическая часть, не вошедшая в материал лекций по темам 1-4	9
ТЕМА 5. Торцевая и поперечная типы накачки твердотельных активных	
элементов	22
ТЕМА 6. Продольная (торцевая) схема накачки	23
ТЕМА 7 Поперечная схема накачки	24
Теоретическая часть, не вошедшая в материал лекций по темам 5-7	25
ТЕМА 8. Схемотехника источников электропитания (драйверов) мощных	ЛД
и сборок ЛД	30
ТЕМА 9. Измерение параметров мощных ЛД и сборок ЛД	31
Теоретическая часть, не вошедшая в материал лекций по темам 8-9	32
Вопросы для самоконтроля по теоретическому материалу	49
Список литературы:	50
Приложение	51

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа студентов (СРС) общепризнанно считается эффективным видом обучения, основанным на самостоятельном формировании студентом знаний, умений, навыков и компетенций. СРС реализацию принципов самообучения, направлена на связанных С саморазвитием личности в процессе обучения, формированием активных методов и технологий познавательной деятельности. Максимальная учебная нагрузка студентов очной формы обучения в соответствии с ФГОС ВПО составляет 54 часа в неделю. При этом планируемый объем СРС занимает значительную часть (примерно 55%) учебной нагрузки студентов Поэтому требуется особенно внимательно отнестись к университета. планированию СРС и её управлению.

Активизация СРС связана с четким планированием содержания и объема самостоятельной работы, организацией и контролем ее проведения, необходимым учебно-методическим и материально-техническим обеспечением, внедрением новых технологий обучения, переосмыслением и изменением содержания и технологий проведения аудиторных занятий.

На преподавателей возлагается управление, включающее планирование работы, консультирование студентов, текущий контроль и анализ результатов учебной работы.

Методические рекомендации по самостоятельному изучению дисциплины представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющий студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной дисциплины. При разработке рекомендаций учитывался тот факт, что часть материалов курса, согласно учебному плану направления, изучается студентом самостоятельно.

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей (внеаудиторная СРС) при освоении данного курса являются:

формирование и изучение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы;

подготовка к лабораторным работам, их оформление;

выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач;

текущий самоконтроль и контроль успеваемости.

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей (аудиторная СРС) в учебном процессе являются:

текущие консультации и контроль по формированию и освоению теоретического содержания дисциплин;

прием и защита лабораторных работ;

консультирование по результатам текущего контроля знаний;

Методические рекомендации по изучению теоретического материала дисциплины «Активные среды твердотельных лазеров» дифференцировано по каждой теме курса. ТЕМА 1. Оптическая накачка — основной тип накачки твердотельных лазерных сред

Основные вопросы темы: оптическая накачка – единственный способ возбуждения активных центров (ионов) твердотельных лазерных сред. Некогерентная (ламповая) и когерентная (лазерная) накачка. Сравнительные характеристики рассматриваемых типов накачки. Квантрон – устройство, обеспечивающее эффективную передачу энергии возбуждения активной среде, равномерное её распределение по объёму активной среды и съём тепла, выделяющегося в активном элементе.

Цель и задачи изучения темы состоит в ознакомлении студента с механизмом оптической накачки: поглощением излучения накачки активной средой и переходом активных центров на верхний лазерный уровень; практической реализации физических принципов при ламповой и лазерной накачке в конструкции конкретного устройства - квантрона.

Основной понятийно-терминологический аппарат: активная среда, оптическая накачка, когерентная/некогерентная накачка, эффективность накачки, полосы поглощения активной среды, квантрон, лазерный диод (ЛД).

Требования к уровню подготовленности студента - студент должен ориентироваться в основных вопросах/понятиях темы, понимать логические связи между ними, быть готовым дать сравнительную оценку двух различных способов оптической накачки – ламповой и при помощи ЛД., представлять преимущества и недостатки каждого из рассмотренных способов.

ТЕМА 2. Физические основы функционирования полупроводниковых лазеров

Основные вопросы темы: Излучательная рекомбинация на прямозонных переходах в полупроводниках. Условие достижения инверсии в полупроводнике (в терминах фермиевских уровней). Инверсия при инжекции носителей в *p-n* переход вырожденного полупроводника. Идея гетероструктуры. Квантоворазмерные лазерные диоды.

Цель и задачи изучения темы состоит в теоретическом ознакомлении студента с зонной структурой полупроводников, механизмами релаксации возбуждения в полупроводниках, методами получения инверсной населённости (лазерного эффекта), схемой гетероперехода.

Основной понятийно-терминологический аппарат: полупроводник, зонная структура, уровень Ферми, излучательная рекомбинация на межзонных переходах, гетероструктура.

Требования к уровню подготовленности студента - студент должен ориентироваться в основных вопросах/понятиях темы, понимать логические связи между ними, представлять физические механизмы излучательной рекомбинации в полупроводниках, формулировать условия достижения инверсной населённости в полупроводнике в терминах уровня Ферми, понимать важность перехода от классического резкого *p-n* перехода к гетеропереходам.

ТЕМА 3. Конструкции мощных лазерных диодов

Основные вопросы темы: типичная гетероструктура мощного лазерного диода, назначение отдельных элементов гетероструктуры, варианты технологического исполнения ЛД, направленные на повышение удельных характеристик полупроводниковых лазеров, основные системы ЛД, изготовлении полупроводников, используемых при мощных И достижимые диапазоны генерации.

Цель и задачи изучения темы состоит в ознакомлении студента с технологиями изготовления ЛД (эпитаксиальный процесс), конструкцией ЛД, назначением отдельных элементов структуры гетеропререхода, а также достигнутыми в современных технологиях предельными параметрами и перспективами развития технологий ЛД.

Основной понятийно-терминологический аппарат: эпитаксиальный процесс, элементы гетероструктуры, системы полупроводников для изготовления гетероструктур, достижимые диапазоны генерации.

Требования к уровню подготовленности студента - студент должен ориентироваться в основных вопросах/понятиях темы, понимать логические связи между ними, представлять основы эпитаксиальной технологии, методы получения диодных гетероструктур, также знать назначение основных элементов таких структур, знать основные системы полупроводников, используемых при изготовлении мощных ЛД.

ТЕМА 4. Многоэлементные полупроводниковые излучатели — линейки и матрицы ЛД

Основные вопросы темы: Факторы, ограничивающие мощностные ЛД. Агрегатирование характеристики одиночных одиночных ЛД В многоэлементные излучающие структуры (линейки И матрицы) _ оптимальный способ наращивания выходной мощности полупроводниковых излучателей. Технологические приёмы выполнения линеек и матриц ЛД. Трудности, связанные с отводом тепла. Сборки с выводом излучения в свободное пространство и в оптическое волокно.

Цель и задачи изучения темы состоит в ознакомлении студента с современными подходами в конструировании мощных (сотни-тысячи Вт выходной оптической мощности) сборок ЛД. Проблема охлаждения мощных сборок.

Основной понятийно-терминологический аппарат: одиночный лазерный диод – линейка ЛД – матрица ЛД. Технология пайки линеек ЛД. Сборка матриц ЛД. Ввод излучения ЛД в оптическое волокно.

Требования к уровню подготовленности студента - студент должен ориентироваться в основных вопросах/понятиях темы, понимать логические связи между ними, знать технологию агрегатирования ЛД в многоэлементные излучатели.

Теоретическая часть, не вошедшая в материал лекций по темам 1-4

Системы термостатирования полупроводниковых лазеров.

Если на семинаре хочется что-то спросить, а ты ничего не понимаешь в теме доклада, то спроси у докладчика: «А как это зависит от температуры»? Ибо от температуры в природе зависит ВСЁ. Ю.П. Райзер, устный научный фольклор

Как следует из datasheet'ов, приведенных в Приложении, для коммерчески доступных образцов ЛД коэффициент полезного действия составляет $40\div50\%$ по параметру «ток-свет». Для лазерных систем данный результат является превосходным. Однако же не менее 50% подводимой электрической мощности диссипирует в тепло, которое отводится системой охлаждения (СО). Эта система должна не только обеспечить требуемый теплосъём, но и поддерживать заданную температуру ЛД с высокой (иногда до 0.1° C) точностью, если предполагается использование полупроводниковых лазеров для накачки твердотельных активных сред.

Рассмотрим эту проблему подробнее. Параметры выходного излучения сильно зависят от температуры. Характер такой зависимости иллюстрируется на рис.1.

Приведенный график показывает, что центральная длина волны даже маломощного полупроводникового лазера дрейфует с температурой. Характерный коэффициент пропорциональности для лазеров ближнего ИК диапазона составляет величину 0.25÷0.30 нм/°С. С мощными приборами ситуация в некотором смысле ещё хуже, ибо не только смещается спектр, он сильно уширяется с ростом тока накачки (рис.2).



Рис. 1. Зависимость центральной длины волны в спектре излучения ЛД от температуры (по материалам

http://www.newport.com/Laser-Diode-Technology/852182/1033/content.aspx).



Рис. 2. Вид спектра излучения мощного ЛД в зависимости от тока накачки. Максимальная мощность Р_{max} =60 Вт. (по материалам «Квантовая электроника», 39, №8, стр. 723, 2009).

Если «холодный» лазер имеет спектр излучения, хорошо согласованный с полосой поглощения активного иона в твердотельной матрице, то без термостабилизации это согласование будет нарушено. Вот почему приходится решать все обозначенные ранее технические задачи по поддержанию температуры ЛД на нужном уровне и с необходимой точностью. Методы и подходы зависят в конечном итоге от мощности охлаждаемых ЛД.

Для относительно маломощных, единичных полупроводниковых лазеров распространённым вариантом является охлаждение/ самым термостабилизация с помощью термобатарей. В физике давно известен эффект Пельтье, состоящий в поглощении или выделении тепла при протекании тока через контакт (*термоспай*) двух разнородных проводников. Количественно поглощённой/выделившейся Q количество теплоты описывается следующим выражением: $Q = \Pi It$, где

I - ток, протекающий через спай,

t - время протекания тока,

П - постоянная, характеризующая материалы термоспая, называемая коэффициентом Пельтье.



Типичная конструкция термобатареи приведена на рис.3.

Рис.3. Схема термобатареи (модуля) Пельтье.

В качестве материалов для изготовления модуля берут полупроводники n и p типа на основе соединений висмута, теллура, ибо для них достигается максимальный коэффициент П. Пакетирование в одной конструкции большого количества (десятки и сотни штук) отдельных термостолбиков позволяет получить значительную холодопроизводительность, до десятков Вт, чего вполне достаточно для одиночного ЛД. Разумеется, для нормальной работы термобатареи тепло с горячей стороны должно отводиться во внешнюю среду. Для чего горячую сторону монтируют на массивный металлический радиатор с обдувом.

Термоэлектрический модуль имеет ряд неоспоримых преимуществ: отсутствие движущихся частей и, следовательно, каких либо вибраций, $0.1^{\circ}C$ (c упомянутой возможность прецизионного точностью В регулирования температуры, возможность реверса (может как охлаждать, так и подогревать статируемый объект). Всё это обуславливает самое широкое применение данной технологии для охлаждения ЛД. К сожалению, возможности масштабирования по отводимой тепловой мощности довольно ограничены, реально достижимый КПД (примерно 30%) заставляет желать лучшего. Относительно маломощные диоды (это особенно характерно для приборов с волоконным выходом) имеют интегрированный в корпус типа «баттерфляй» охладитель. Фото показано на рис.4.



Рис. 4. ЛД с интегрированным охладителем и термодатчиком в корпусе «баттерфляй».

За массивное основание такой корпус 4-мя винтами притягивается к радиатору. Для улучшения теплового контакта обычно на сопрягаемые поверхности наносится термопаста. Подвод напряжения к самому ЛД, термобатарее, датчику температуры осуществляется через выводы на боковых стенках.

Следует иметь в виду, что для функционирования охладитель Пельтье должен включаться в контур соответствующей системы управления, которая измеряет сигнал рассогласования между фактической температурой корпуса и заданной, вырабатывает соответствующий ток, протекающий по термоспаям. Схемотехника подобных устройств – тема отдельного разговора, здесь этот вопрос рассматриваться не будет. Отметим лишь, что многие ведущие производители (Analog Devices, MAXIM, Linear technology и др.) выпускают законченные решения, выполненные в виде специализированных чипов.

Выходная мощность DPSS лазеров давно перешагнула киловаттный рубеж. Задача отвода тепла от источника подобной мощности решается традиционной системой водяного охлаждения. Основная трудность же состоит в том, в отличие от классической водяной СО для охлаждения твердотельных лазеров с ламповой накачкой, температура хладагента должна стабилизироваться с высокой точностью.

Один из возможных вариантов выполнения модулей полупроводниковой накачки с водяным охлаждением описан в работах [1,2]. Сборочной единицей являются в данном случае диодные линейки *Silver Bullet* американской компании NG Cutting Edge Optronics. В Приложении приведены характеристики более современной модификации *Golden Bullet*. Для получения требуемой выходной мощности линейки устанавливаются на теплоотводы в количестве 5, 7 и 19 шт. методом пайки. Данные таких модулей приведены в таблице 1.

Таблица 1

Тип	Мощность	Длина волны	Напряжение	Номинальный
модуля	излучения,	в максимуме	питания, В	ток накачки,
	Вт	спектра, нм		Α
КЛ4-100	100	805±2	10	25
КЛ4-280	280		25	
КЛ4-760	760		70	

Технические характеристики модулей диодной накачки

Чтобы обеспечить требуемый температурный режим диодов, необходимо иметь эффективные теплообменники с низким термическим сопротивлением, которое В основном определяется интенсивностью теплообмена на границе "стенка-вода". Для достижения максимальной эффективности теплообмена щелевой канал выполняется в виде медной микроканальной структуры со специфическим оребрением.



Рис. 5. Структура теплообменников с микрооребренем. (Слева – эскиз, справа - микрофотография). h=1 мм, s=0.2 мм.

Для охлаждения всей системы использовался чиллер RRS-0250-AC Bay VoltexCorp., обеспечивающий прокачку хладагента с расходом 20 л/мин и

стабилизирующий его температуру с точностью $\pm 0.1^{\circ}$ C. В подобных чиллерах, гарантирующих отвод тепловой мощности в единицы кВт, для поддержания температуры хладагента используется система компрессионного типа, совсем как в домашнем холодильнике. Только мощность её соответствующая.

В самых современных вариантах выполнения сборок мощных ЛД производитель интегрирует теплообменник в единую конструкцию излучающего модуля. Типичный пример показан на рис.6.



Рис. 6. Лазерная диодная сборка с двумя 36-линеечными стеками с микроканальным охлаждением упоминавшейся ранее фирмы NGCEO.

Методы сужения спектра излучения мощных ЛД и сборок таких ЛД

В работе [3] В.Ф. Крупке предложил использовать лазерные диоды для накачки атомов щелочных металлов. Термин DPAL (diode pumped alkali laser), ныне широко используемый в англоязычной литературе, был предложен именно им. Это тот редчайший случай, когда оптическая накачка применима для лазерных активных сред, находящихся в газовой фазе. В данном случае лазерные диоды привносят все те же преимущества, что и в рассмотренном ранее варианте их использования для накачки твердотельных

лазерных систем. Но их применение имеет ряд специфических черт, а именно:

- центральная длина волны в спектре генерации ЛД должна точно совпадать с длиной волны соответствующего D₂ перехода атома щелочного металла;
- ширина спектра ЛД должна согласовываться с относительно узкой линией D₂ перехода. Это требование существенно жёстче, чем требование на ширину спектра ЛД для накачки твердотельных активных элементов;
- 3. наконец, обладать яркостью, достаточной для достижения необходимой инверсии на лазерном переходе.

Что касается первого требования, то приведенный ниже рисунок 7 наглядно демонстрирует ситуацию, имеющую место на сегодняшний день.



Рис. 7. Энергии фотонов/ длины волн, необходимые для накачки атомов щелочных металлов и спектральные области излучения основных типов полупроводниковых лазеров.

Очевидно, что длины волн, излучаемые самыми распространёнными и технологически отработанными ЛД на AlGaAs и InGaAs, обеспечивают возбуждение K, Rb и Cs. AlGaAs диоды накачивают Nd³⁺ содержащие среды,

InGaAs – Yb³⁺. Для «экзотических» Li и Na потребуются дополнительные разработки.

Выполнение же п.2 требований, предъявляемых к ЛД, пригодных для оптического возбуждения щелочных атомов сопряжено со значительными трудностями. Если взять любой мощный ЛД/линейку/ матрицу на AlGaAs (соответствующие данные приведены в Приложении), то окажется, что типичная ширина спектра излучения таких источников составляет 2÷3 нм. Такое значение будет не всегда удовлетворительным даже в случае твердотельных активных сред с их широкими полосами поглощения излучения накачки. Один из классических примеров такого рода показан на рис. 8, где приведен спектр поглощения Nd: YAG в диапазоне длин волн 780-900 нм. Наиболее распространенной длиной волны накачки для Nd: YAG лазеров является 808 нм. Существует также соседний пик примерно на 805 нм, что вместе с первым создает эффективную полосу поглощения шириной 5.5 нм, и это идеально подходит для накачки стандартными сборками лазерных диодов. Однако есть технические преимущества, связанные с накачкой Nd: YAG на более длинных волнах. В частности, малый квантовый дефект при накачке на таких волнах приводит к слабой тепловой линзе и меньшим потерям из-за деполяризации. В результате, накачка Nd: YAG на 869 или 885 нм является привлекательной альтернативой во многих конструкциях лазера. К сожалению, ширина пиков поглощения на этих длинах волн значительно уже (~ 1 нм и ~ 3 нм, соответственно), и поэтому для накачки требуются диоды с узким спектром излучения.

И понятно, что большая (~ 3 нм) ширина спектра накачки совершенно не подходит для узкой линии D₂. В рассматриваемом случае приходится принудительно суживать спектр мощных ЛД. Стандартом de facto стало использование внешних элементов для фиксации длины волны для создания сборок лазерных диодов с узким спектром длин волн. Наибольшую популярность получил подход, основанный на применении объемных

брэгтовских решеток (VBG-Volume Bragg Grating) в составе сборок ЛД. Не вдаваясь в подробности: VBG по существу представляет объёмную голограмму, работающую по схеме Ю.П. Денисюка и осуществляющую спектральную селекцию падающего на неё излучения. Удаётся достичь спектральной ширины излучения около 0,5 нм (FWHM) при выходной мощности от десятков Вт до единиц кВт. Применительно к решёткам ЛД, выпускаемым фирмой <u>Northrop Grumman Cutting Edge Optronics</u> (NGCEO), основная идея выглядит следующим образом (рис.9).



Рис 8. Кривая поглощения для для Nd: YAG (примерные ширины полос поглощения приведены для справки).



Рис 9. Схема решения, используемого NGCEO при производстве сборок со стабилизированной длиной волны излучения (не в масштабе!).

Сначала линейка мощная лазерная диодная припаивается к микроканальному радиатору охлаждения. Данная подсборка проходит предварительное тестирование для проверки надлежащей работы и проверку надежности припайки и качества зеркал. Необходимое количество этих подсборок (с N = 1 до 56, в зависимости от пожелания заказчика) затем спаиваются в мощную сборку. Затем к каждому радиатору прикрепляется коллимирующая по быстрой оси (FAC) линза. Наконец, небольшая VBG индивидуально юстируется относительно каждой пары линейка / линза и крепится к раме сборки. Когда устройство работает, свет, излучаемый диодной линейкой, коллимируется линзой и попадает на решетку. Решетка селективно отражает свет с определенной длиной волны (определяется шагом решетки) обратно через линзу в оптический резонатор диодной линейки. Этот метод обратной связи заставляет диоды генерировать свет с определенной (заданной решеткой) длиной волны при вариации рабочих параметров (температуры, тока и пр.).





Рис 10. Спектры излучения 36-линеечного стека до и после добавления VBG.

Показанный выигрыш от применения брегговских решёток может сводиться к минимуму, если добавление VBG приводит к чрезмерно негативному влиянию на выходную мощность сборок. Однако эксперимент показал, что для рассмотренного 36-линеечного стека добавление спектральной селекции снизило мощность примерно на 8% при токе накачки 80 А. Но при этом резко возросла доля мощности накачки, попадающей в полосы поглощения АЭ. В результате общее снижения мощности сборки составляет эффект второго порядка малости.

Применительно к случаю диодной накачки щелочных атомов наибольших успехов достигла компания DILAS Diode Laser Inc.(www.dilas.com)/ (см. рис.11).





Таким образом, ширина спектра излучения мощной (1 кВт) сборки может быть сужена до величины ~0.1 нм, что является превосходным результатом.

TEMA 5. Торцевая и поперечная типы накачки твердотельных активных элементов

Основные вопросы темы: Продольная и поперечная схемы накачки активной среды твердотельных лазеров. Накачиваемый объём при различных типах накачки. Неоднородность распределения плотности мощности накачки по объёму АЭ и способы улучшения этого параметра.

Цель и задачи изучения темы состоит в ознакомлении студента с двумя различными схемами накачки: продольной и поперечной, выяснении специфических областей применения, методах улучшения характеристик каждой из схем.

Основной понятийно-терминологический аппарат: продольная схема накачки АЭ, поперечная схема накачки АЭ, неоднородность распределения плотности мощности накачки по объёму АЭ.

Требования к уровню подготовленности студента - студент должен ориентироваться в основных вопросах/понятиях темы, понимать логические связи между ними, представлять преимущественные области использования продольной и поперечной схем накачки, а также методы преодоления недостатков, присущих каждой из них.

ТЕМА 6. Продольная (торцевая) схема накачки

Основные вопросы темы: Продольная схема накачки. Варианты продольной схемы, направленные на улучшение характеристик выходного излучения лазера. Конструкции квантронов, реализующих продольную схему накачки. Предельно достижимые параметры.

Цель и задачи изучения темы состоит в ознакомлении студента с общей схемой продольной накачки и её основных вариантов, конкретными техническими решениями, применяемыми в конструкциях квантронов маломощных твердотельных лазеров.

Основной понятийно-терминологический аппарат: продольная схема накачки, согласование объёма мод резонатора и накачиваемого объёма, квантрон.

Требования к уровню подготовленности студента - студент должен ориентироваться в основных вопросах/понятиях темы, понимать наивысшую эффективность продольной схемы накачки, присущие её ограничения, методы снижения влияния вредных факторов на характеристики выходного излучения, а также область применения данной схемы (относительно маломощные лазеры с выходной мощностью ~ 10 Вт).

ТЕМА 7 Поперечная схема накачки

Основные вопросы темы: Поперечная схема накачки. Варианты поперечной схемы с прямым вводом излучения накачки и с оптическими системами подвода излучения накачки. Конструкции квантронов, реализующих поперечную схему накачки. Предельно достижимые параметры.

Цель и задачи изучения темы состоит в ознакомлении студента с общей схемой поперечной накачки и её основных вариантов (с прямым и опосредованным вводом излучения накачки в активную среду), конкретными техническими решениями, применяемыми в конструкциях квантронов мощных твердотельных лазеров.

Основной понятийно-терминологический аппарат: поперечная схема накачки, схема с прямым вводом излучения накачки в активную среду, схема с оптическими системами подвода излучения накачки, квантрон.

Требования к уровню подготовленности студента - студент должен ориентироваться в основных вопросах/понятиях темы, понимать необходимость перехода к поперечной схеме накачки для масштабирования выходной мощности твердотельных лазеров до киловаттного уровня.

Теоретическая часть, не вошедшая в материал лекций по темам 5-7

Лазеры с активным элементом в виде диска (Thin Disk Laser)

Подавляющее число квантронов твердотельных лазеров киловаттного уровня выходной мощности строится по традиционной схеме: активный элемент имеет цилиндрическую форму с характерным отношением диаметра к длине ~ 1:10. При необходимости увеличения выходной мощности до десятков кВт разработчик сталкивается с рядом непреодолимых трудностей, носящих фундаментальный характер. Один из них – критическое ухудшение качества лазерного пучка из-за тепловой линзы, возникающей вследствие объёмного выделения тепла в АЭ.

Для уменьшения влияния термооптических искажений в активной среде твердотельных лазеров была предложена конструкция, получившая название «дисковый лазер». Принцип работы такого лазера основан на использовании охлаждаемого АЭ в форме диска. Высокая эффективность охлаждения лазерной среды обеспечивается за счет большой площади поверхности диска в сравнении с его объемом. Поэтому средняя мощность излучения в пучке достигает высоких значений. На рис.12 показано, как за счет охлаждения в пределах дискового лазера не возникает эффект тепловой линзы и генерируется осевой поток тепла. Этот же рисунок демонстрирует эволюционный процесс перехода от стержневой конструкции к концепции дискового лазера. Из-за того, что стержневой лазер охлаждается через цилиндрическую поверхность кристалла, через нее распространяется двухмерный формирующий параболический профиль поток тепла, искажения. Зависимость показателя преломления от температурного температуры приводит к возникновению эффекта тепловой линзы. Такая линза ухудшает качество выходящего луча и ограничивает его выходную мощность. Тонкий диск, напротив, охлаждается через покрытие с обратной стороны кристалла с высокими отражающими свойствами, при этом

генерируется одномерный поток тепла. Как следствие, температурный градиент распределяется параллельно лазерному лучу и не приводит к появлению эффекта тепловой линзы.



Рис. 12. Температурный градиент в активном элементе для традиционной стержневой и дисковой геометрии активного элемента

На практике тонкий лазерный кристалл в дисковых лазерах с высокой мощностью либо соединен с теплоотводящим элементом, либо охлаждается

принудительно. В обоих случаях нежелательное воздействие эффекта оптимальной компоновкой тепловых ЛИНЗ устраняется элементов Коэффициент лазера. теплопроводности конструкции дискового охлаждающего радиатора кристалла непосредственно зависит от площади зоны накачки. При постоянной температуре кристалла достигаемая средняя выходная мощность прямо пропорциональна площади зоны накачки и, соответственно, площади поверхности лазерного луча на диске. Это является уникальной особенностью дисковых лазеров и позволяет масштабировать среднюю мощность при постоянной энергии луча на диске. Данное свойство важно для мультикиловаттных источников, потому что оно позволяет регулировать мощность, не изменяя при этом параметры, оказывающие влияние на надежность системы.

На первый взгляд, определенную проблему ставит выбор толщины кристалла, необходимой для эффективного отвода тепла. Потому что данная схема предполагает низкую способность поглощения энергии накачки. Однако геометрическая схема накачки дискового лазера позволяет найти изящное решение этой проблемы. Процесс накачки можно представить в виде многоканальной конфигурации, состоящей из параболического зеркала и системы отклонения. На рис.13 показана типовая оптическая схема

Параболическое зеркало фокусирует коллимированный пучок накачки, который поступает в резонатор лазерного кристалла. После частичного поглощения оставшаяся часть пучка отражается от зеркала, имеющего высокий коэффициент отражения, на тыльной стороне диска. В результате многократного отклонения через призмы и параболического зеркала получается в общей сложности до 20 поглощений при прохождении через диск. Этим достигается высокая эффективность поглощения световой энергии пучка накачки. Оптическая схема таких резонаторов допускает не строгие ограничения яркости для источника накачки. Как правило, для

накачки дискового лазера с высокой средней мощностью требуются пучок, качество которого определяется величиной 500 мм•мрад.







Рис. 13. Оптическая схема для дисковых лазерных устройств с высокой средней мощностью. а) – собственно резонатор, б) – схема многопроходовой накачки.

Именно поэтому допускается применение как волоконных лазерных диодов, так и лазерных диодных схем с равномерным распределением интенсивности. С точки зрения практического использования лазерные диоды с равномерным распределением интенсивности более предпочтительны ввиду заметно меньших затрат, приходящихся на один ватт мощности накачки.

Ниже на эскизе (рис.14) представлен усилительный модуль на основе дисковой геометрии активной среды с максимальной мощностью накачки 30 кВт, разработанный German Aerospace Center совместно с фирмой TRUMF.



Рис. 14. Мощный усилительный модуль с дисковым активным элементом. Мощность накачки ~ 30кВт.

ТЕМА 8. Схемотехника источников электропитания (драйверов) мощных ЛД и сборок ЛД

Основные вопросы темы: вольт-амперные характеристики (ВАХ) прямосмещённого гетероперехода. Необходимость питания ЛД от источника тока. Линейный токовый драйвер на операционном усилителе (ОУ). Схемотехника мощных импульсных драйверов с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ).

Цель и задачи изучения темы состоит в ознакомлении студента со схемотехникой источников накачки (драйверов) мощных ЛД, линеек и матриц ЛД.

Основной понятийно-терминологический аппарат: операционный усилитель (ОУ), схема линейного источника тока, широтно-импульсная модуляция (ШИМ), импульсное питание сборок ЛД.

Требования к уровню подготовленности студента - студент должен ориентироваться в основных вопросах/понятиях темы, понимать логические связи между ними, понимать основные параметры мощных ЛД как электрической нагрузки, формулировать преимущества и недостатки схемотехники линейных и импульсных источников питания (драйверов) ЛД и их сборок.

ТЕМА 9. Измерение параметров мощных ЛД и сборок ЛД

Основные вопросы темы: Основные параметры и характеристики лазерного излучения: энергетические, пространственно-временные. Методы измерения основных характеристик излучения ЛД. Измерительная аппаратура.

Цель и задачи изучения темы состоит в ознакомлении студента с методами и аппаратурой для измерения основных характеристик излучения мощных ЛД и сборок таких ЛД.

Основной понятийно-терминологический аппарат: выходная мощность ЛД, ВАХ ЛД, угловая расходимость излучения, методы измерения.

Требования к уровню подготовленности студента - студент должен ориентироваться в основных вопросах/понятиях темы, понимать логические связи между ними, быть готовым объяснить методы измерения параметров излучения ЛД.

Теоретическая часть, не вошедшая в материал лекций по темам 8-9

Характеристики спектральных приборов с одномерной дисперсией

Так как в теоретической части курса и лабораторном практикуме приходится постоянно оперировать понятием «ширина спектра излучения лазерного диода», измерять этот параметр экспериментально, исследовать поведение спектра в зависимости от режимов работы полупроводникового лазера, то следует дать студентам хотя бы минимальные представления о классических спектральных приборах с одномерной дисперсией. Изложенный ниже конспект вводит основные понятия и определения, а также позволяет понять основную схему классических спектрографов, используемых в лабораторных работах.

Образование спектра.

На рис. 15. приведена схема спектрального прибора (для определённости призменного) с одномерной дисперсией.



Рис. 15. Схема спектрального прибора с одномерной дисперсией. Показанные лучи соответствуют построению изображения центральной точки щели.

Параметры, относящиеся к частям оптической схемы до диспергирующей системы, имеют индекс 1, а после неё - 2. Оптические оси коллиматора и камеры лежат в одной плоскости, ортогональной преломляющему ребру призмы (или штрихам решётки). Эта плоскость именуется *главной* и является плоскостью дисперсии. В фокальной плоскости объектива *O*₁ располагается узкая щель, узкая сторона которой параллельна главной плоскости, а широкая – перпендикулярна ей. При её освещении исследуемым излучением саму щель можно рассматривать, как несамосветящийся источник, изображение которого строится коллиматорным *O*₁ и камерным *O*₂ объективом в фокальной плоскости последнего.

Положим, что щель освещается монохроматическим излучением, а вся оптика прибора – идеальна. Введём понятие *углового увеличения диспергирующей* системы Г. Согласно рис 16. $\Gamma = d\varphi/d\psi$.



Рис. 16. К понятию углового увеличения диспергирующей системы (призмы).

При построении изображения щели следует учесть дифракционные эффекты, так как из приведенных выше двух рисунков видно, что это изображение строится световыми пучками, ограниченными по поперечному сечению. Однако на первом этапе нашего рассмотрения ограничимся геометрооптическим подходом, который справедлив при достаточно широкой входной щели. Выполненное построение представлено на рис. 17:



Рис. 17. Образование изображения щели в приближении геометрической оптики.

Если ширина входной щели равна s₁, то параллельные пучки, выходящие из коллиматорного объектива O1 образуют между собой угол $\Delta \psi$ (для противоположных крайних точек щели), причём $\Delta \psi = s_1/f_1$. На выходе из-за углового увеличения угол схождения лучей $\Delta \varphi = \Gamma \Delta \psi$. На выходе камерного объектива пучки сходятся в его фокальной плоскости, причём расстояние между точками, соответствующими краям щели, равно $s_2 = \Delta \varphi f_2$. Комбинируя, легко получить связь поперечного размера щели с размером её изображения: $s_2 = s_1 \frac{f_2}{f_1} \Gamma$. Рассуждая аналогично, получим выражение, связывающее высоту изображения щели с её реальным размером: $h_2 = h_1 \frac{f_2}{f_1}$. Следует отметить, что далеко не всегда фокальная поверхность камерного объектива (обычно плоскость, так как фокусировать изображение спектра на плоскость проще всего) ортогональна его оптической оси, а наклонена на угол ε относительно оси (см. рис. 20). Это происходит из-за того, что очень часто объектив камеры не ахроматизирован, то есть фокальный отрезок зависит от длины волны. В этом случае $s_2^* = \frac{s_2}{\sin \varepsilon} = s_1 \frac{f_2}{f_1} \frac{\Gamma}{\sin \varepsilon}$. Таким образом, в общем случае ширина s_2^* есть

величина, зависящая от длины волны.

Получим некоторые простые выражения, связывающие характеристики щели и её изображения. Для этого рассмотрим ход лучей в плоскости дисперсии, а также в плоскости, ей ортогональной (рис.18).



Рис. 18. Ход лучей в плоскости дисперсии.

Для простоты положим $\varepsilon = \pi/2$, а также примем, что оптическая схема прибора целиком находится в воздухе/ вакууме (что практически всегда соответствует действительности). Тогда согласно теореме Лагранжа – Гельмгольца можно записать

$$s_1 t g u_1 = s_2 t g u_2$$
 где $t g u_1 = \frac{D_1}{2f_1}$ и $t g u_2 = \frac{D_2}{2f_2}$

Отсюда имеем формулу $s_2 = s_1 \frac{f_2}{f_1} \frac{D_1}{D_2}$ или в симметричном виде $\frac{s_1}{f_1} D_1 = \frac{s_2}{f_2} D_2$

Сравнивая с формулой для углового увеличения диспергирующей сиситемы, для Г получаем следующее:

 $\Gamma = d\varphi/d\psi = D_1/D_2$

Применив вновь уравнение Лагранжа – Гельмгольца, получим

$$h_1 tgu_1' = h_2 tgu_2'$$

Так как

$$tgu'_1 = \frac{H}{2f_1}$$
 If $tgu'_2 = \frac{H'}{2f_2}$, TO

$$h_2 = h_1 \frac{f_2}{f_1} \frac{H}{H'} = h_1 \frac{f_2}{f_1}$$
 или же в симметричном виде $\frac{h_1}{f_1} H = \frac{h_2}{f_2} H$



Рис. 19. Ход лучей в плоскости, в которой лежат длинные стороны щели и её изображения.

Теперь, перемножив почленно симметричные выражения, связывающие размеры щели с размерами её изображений, получим

$$s_1 h_1 \frac{D_1 H}{f_1^2} = s_2 h_2 \frac{D_2 H}{f_2^2}$$
 или с использованием обозначений рис. 17. $s_1 h_1 \Omega_1 = s_2 h_2 \Omega_2$,

где Ω_i - соответствующие телесные углы, охватывающие входной и выходной пучки.

Основные характеристики спектральных приборов и связь между ними.

Линейная дисперсия.

Рассмотрим упрощённую схему спектрографа с *одномерной дисперсией* (рис.20).

Пусть во входном излучении присутствуют две близких длины волны λ и $\lambda + d\lambda$. Тогда в фокальной плоскости образуются пара близкорасположенных изображений входной щели шириной s_2^* .Очевидно,

что $dl = f_2 d\varphi$ и $dl^* = \frac{dl}{\sin \varepsilon} = \frac{f_2}{\sin \varepsilon} d\varphi$. Можно ввести в рассмотрение следующую



Рис. 20. К выводу выражения для линейной дисперсии.

Она называется линейной дисперсией спектрального прибора. Величина $\frac{d\varphi}{d\lambda}$ угловая дисперсия диспергирующей системы.

На практике, однако, чаще пользуются понятием *обратной линейной дисперсии* $d\lambda/dl^*$, выражая её в *нм/мм* или *А/мм*. Понятно, что чем меньше данный параметр, тем на большее расстояние разнесены центры изображений соседних линий, и тем больше деталей можно разглядеть в спектре (рис.21).

Очевидно, что $\Delta l = (\lambda_1 - \lambda_2) \frac{dl}{d\lambda}$. Также очевидно, что только в случае $s_2 < \Delta l$ изображения щелей не перекрываются. Поэтому напрашивается вывод о том, что надо работать как можно с более узкими щелями. Проведём простой эксперимент, а именно, будем, начиная с широких щелей, измерять ширину её изображения в монохроматическом свете, постепенно уменьшая таковую ширину. Результат изобразится в виде графика на рис.22.



Рис. 21. Изображение щели в свете двух близких длин волн λ_1 и λ_2 .





При уменьшении ширины входной щели $s_1 < s_{10}$ ширина eë изображения $s_2 \cong s_{20} = const$ не меняется. Изменяется лишь распределение освещённости в изображении: оно перестает быть равномерным и сама освещённость стремиться к нулю. Причиной такого отступления от законов геометрической оптики являются дифракционные эффекты на апертурной диафрагме спектрального прибора. Ширина щели *s*₁₀, при которой перестаёт быть справедливым геометрооптический подход, называется нормальной шириной входной щели. Eë значение определяется параметрами

спектрального прибора и может быть вычислено только в приближении волновой оптики.

Разрешающая сила спектрального прибора. Понятие аппаратной функции.

Как и для прочих оптических приборов, решающую роль в способности спектрального прибора изобразить отдельно близлежащие линии, играет дифракция. Рассмотрим подробно ограничение световых пучков в таком приборе. Согласно рис. 15, основной диафрагмой, ограничивающей апертуру пучков, дающих изображение входной щели, служит диспергирующая система.

Для начала рассмотрим случай бесконечно узкой щели (*s*₁ << *s*₁₀), освещенной монохроматическим излучением. Для нахождения распределения интенсивности в плоскости дисперсии следует решить задачу о дифракции Фраунгофера плоской монохроматической волны на перпендикулярной пучку диафрагме шириной *D*₁ (рис.23).



Рис. 23. К дифракции пучка на диспергирующей системе.

Выпишем результат, известный из волновой оптики:

$$I(\varphi') = I_0 \left(\frac{\sin u}{u}\right)^2 \qquad \qquad \text{где } u = \frac{k\Delta}{2} = \frac{\pi}{\lambda} \Delta = \frac{\pi}{\lambda} D_1 \sin \psi'$$

Соответствующее распределение изображено на рис 24.



Рис. 24. График дифракционного распределения.

С учетом углового увеличения можем получить выражения для угловой/ линейной ширины дифракционного распределения в фокальной плоскости камерного объектива: $\Delta \varphi_1 = \Delta \psi' \Gamma = \lambda / D_2$ $\Delta l_1 = f_2 \Delta \varphi_1 = f_2 \frac{\lambda}{D_2}$.



Рис. 25. Дифракционная картина в фокальной плоскости камерного объектива.

Рассмотрим случай реальной ширины входной щели ($s_1 \ge s_{10}$). В этом случае при некогерентном её освещении в фокальной плоскости камеры произойдёт суммирование интенсивностей от участков, составляющих широкую щель (рис.26).



Рис. 26. Наложение распределений интенсивности в фокальной плоскости камеры.

Здесь принято, что линия дисперсии направлена вдоль оси абсцисс, а начало координат расположено в центре геометрического изображения щели.

Для нахождения результирующего распределения интенсивности вдоль выходной щели просуммируем интенсивности всех бесконечно узких составляющих в пределах геометрического изображения щели. Опуская промежуточные вычисления, приведём соответствующие распределения для различных значений параметра $s_2/\Delta l_1$ (рис.27).

При $s_2/\Delta l_1 \approx 1$ распределение отличается от геометрооптическогог и близко к дифракционному с полушириной $\alpha_0 = 0.886\Delta l_1$. Теперь нормальную ширину щели можно определить из условия равенства геометрической

ширины изображения входной щели s_{20} ширине главного дифракционного

максимума
$$\alpha_{\partial}$$
: $s_{20} = s_{10} \frac{\Gamma f_2}{f_1} = \alpha_{\partial}$.



Рис. 27. Распределение интенсивности по ширине выходной щели.

Обычно пренебрегают множителем 0.866 и полагают $\alpha_{\partial} \cong \Delta l_1 = f_2 \lambda / D_2$:

Тогда
$$s_{10} = f_1 \frac{\lambda}{D_2} \frac{1}{\Gamma} = f_1 \frac{\lambda}{D_1}$$

Рассмотрены дифракционные явления в главной плоскости спектрального прибора в направлении дисперсии. Аналогично можно рассмотреть дифракцию в плоскости, перпендикулярной плоскости дисперсии. Так как величина высоты щели *h*₂ составляет миллиметры/ десяток мм, что много больше ширины соответствующего дифракционного максимума, то дифракционными эффектами в данном случае можно пренебречь и пользоваться геометрической оптикой.

Однако, по аналогии с теорией дифракционной решётки, знания одной только дисперсии недостаточно, чтобы однозначно решить вопрос о том, будут ли две близкорасположенные линии наблюдаться раздельно. Необходимо ввести новую величину – *разрешающую силу прибора*. По определению $R = \lambda/\delta\lambda$.

В спектроскопических исследованиях требуется не только разрешать близкорасположенные линии, но также определять их форму, ширину, относительную интенсивность и прочие параметры. То есть необходимо степени наблюдаемые/ знать, В какой измеряемые параметры В регистрируемых спектрах соответствуют истинным характеристикам излучения, подаваемого на входную щель. Проведенное рассмотрение показывает, что реальный спектральный прибор всегда вносит искажения в регистрируемый спектр, в результате чего последний всегда отличается от истинного спектра. Аппаратные искажения носят систематический характер и определяются (в широком смысле слова) конструкцией применяемого прибора. Однако в регистрируемый спектр вносят вклад и случайные погрешности, вызванные шумами измерительного тракта.

Рассмотрим систематическую составляющую этой сначала погрешности. Даже если в оптическом тракте прибора аберрации пренебрежимо малы, то даже в этом случае прибор не является идеальным: из-за дифракционных эффектов изображение бесконечно узкой входной щели в строго монохроматическом свете имеет конечную (дифракционную) ширину α_{a} . В присутствии аберраций ситуация существенно усложняется. Не останавливаясь на этом вопросе по существу, отметим лишь, что ширина результирующего распределения больше дифракционного α_{λ} и может существенно отличаться от последнего по форме. Наконец, при $s_1 >> s_{10}$, распределение интенсивности на выходе спектрального прибора близко к прямоугольному с шириной s₂, определяемой из геометрической оптики. Таким образом, при монохроматическом освещении входной щели в общем случае её изображение всегда будет иметь конечную ширину и некоторое сложное распределение интенсивности дисперсии. Такое вдоль распределение монохроматической спектральной линии в фокальной плоскости камерного объектива получило название аппаратной функции (далее $A.\Phi.)/$ инструментального контура спектрального прибора (рис.28).



Рис. 28. Вид аппаратной функции спектрального прибора.

Для аппаратной функции обычно вводится координата ξ , отсчитываемая от точки, где $A(\xi) = A(0) = A_0$ имеет максимум. Также вводится понятие ширины А.Ф. α , равной расстоянию между точками, для которых $A(\xi) = A_0/2 = A(\alpha/2)$.

Конечная ширина А.Ф. реальных приборов приводит к тому, что две близкие линии с длинами волн λ и $\lambda + \delta \lambda$ могут наблюдаться раздельно/ разрешаться (рис. 29а) или сливаться в одну неразрешённую линию (рис. 29б) в зависимости от соотношения между α и *dl*.



Рис. 29. Наложение аппаратных функций для линий с длинами волн λ и $\lambda + \delta \lambda$ при $dl > \alpha$ (a) и $dl < \alpha$ (б).

Таким образом, задача о разрешающей силе спектрального прибора сводится к задаче о разрешении двух близкорасположенных А.Ф. Существует множество критериев разрешения. Мы будем считать, что две монохроматические линии λ и $\lambda + \delta \lambda$ одинаковой интенсивности разрешены, если $dl = \alpha$, то есть расстояние между центами соответствующих А.Ф. равно их ширине (рис.30).



Рис. 30. Наложение аппаратных функций для линий с длинами волн λ и $\lambda + \delta \lambda$ при $dl = \alpha$.

При таком определении легко записать:

$$I_{\min} = A_0/2 + A_0/2 = A_0$$
 $I_{\max} = A_0 + \Delta I$ $\frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max}} = \frac{\Delta I}{I_{\max}}$

Где величина провала в распределении интенсивности ∆*I* определяется конкретным видом А.Ф. При определении минимально обнаружимой величины провала и, следовательно, о разрешении налагающихся А.Ф., надо принимать во внимание наличие случайных ошибок измерения, что продемонстрировано на рис.31.



Рис. 31. Разрешение наложенных А.Ф. в идеальном случае (а) и при наличии шумов измерительного тракта (б).

Очевидно, что если в случае (a) налицо уверенное разрешение, то во втором случае наличие двух близких линий маскируется шумами.

Так как любой вид аппаратных искажений (аберрации, шумы измерений и т.п.) только увеличивает результирующую ширину А.Ф. по сравнению с дифракционной А.Ф., то любой прибор имеет при дифракционной аппаратной функции максимальную достижимую способность, разрешающую именуемую теоретической/ предельной/ дифракционной.

Каждой точке линии дисперсии можно приписать определенную длину волны/ частоту. Поэтому линейную ширину А.Ф. α можно выразить в спектральных единицах, хотя, всем точкам контура А.Ф. соответствует одна и та же длина волны λ . Если обратная линейная дисперсия в той части фокальной поверхности камерного объектива, где мы наблюдаем излучение, равна $d\lambda/dl$, то интервал длин волн $\delta\lambda$, на участке, равном ширине А.Ф. α , будет $\delta\lambda = \alpha \frac{d\lambda}{dl}$ и называется спектральной шириной аппаратной функции.

Из принятого критерия разрешения А.Ф. следует, что разрешающая способность спектрального прибора есть

$$R = \frac{\lambda}{\delta \lambda} = \frac{\lambda}{\alpha} \frac{dl}{d\lambda}$$

То есть, величина *R* определяется шириной А.Ф. и линейной дисперсией. В зависимости от типа спектрального прибора, раскрытия входной щели величины α и $dl/d\lambda$ могут быть как независимыми, так и взаимосвязанными.

Если перейти в выражении для *R* к угловым величинам, то получим следующую формулу:

$$R = \frac{\lambda}{\delta \lambda} = \frac{\lambda}{\alpha} \frac{dl}{d\lambda} = \frac{\lambda}{\alpha} f_2 \frac{d\varphi}{d\lambda}$$

Если теперь учесть, что для дифракционной А.Ф. $\alpha = \Delta l_1 = f_{2\lambda}/D_2$, то для теоретической разрешающей способности получим: $R_0 = D_2 \frac{d\varphi}{d\lambda}$

В последнее выражение входят только параметры диспергирующего элемента.

Вопросы для самоконтроля по теоретическому материалу

- 1. Физические принципы оптической накачки твердотельных лазерных сред;
- 2. Техническая реализация некогерентной (ламповой) накачки;
- 3. Техническая реализация когерентной (полупроводниковой) накачки;
- 4. Основные принципы конструирования квантронов;
- 5. Сравнительные характеристики ламповой и полупроводниковой накачки.
- 6. Физические механизмы генерации света в полупроводниках;
- 7. Гетероструктуры основной тип лазерных диодов;
- 8. Квантоворазмерные ЛД. Их преимущества;
- 9. Схемы типичных полупроводниковых гетероструктур;
- 10 Линейки и матрицы ЛД –способ наращивания выходной мощности
- 11 Продольная (торцевая) схема накачки;
- 12 Поперечная схема накачки;
- 13 Возможные области применения продольной и поперечной схем;
- 14 Варианты схем квантронов для продольной накачки (конструктивные
- 15 Варианты схем квантронов для поперечной накачки (конструктивные
- 16 Накачка активных элементов нетрадиционной формы (тонкий слэб, диск);
- 17 ЛД как нагрузка источника питания. Необходимость токового питания ЛД;
- 18 Схема линейного токового драйвера на операционном усилителе;
- 19 Методы построения мощных драйверов для питания ЛЛД/ МЛД;
- 20 Измерение спектральных характеристик излучения полупроводниковых
- 21 Расходимость излучения мощных ЛД.

Список литературы:

- И.В. Глухих, С.С. Поликарпов, С.В. Фролов, А.С. Волков, В.В. Привезенцев «Охлаждение лазерных диодных сборок конструкции Silver Bullet», Журнал технической физики, 2010, 80, № 6, стр. 101-105
- И.В. Глухих, С.А. Димаков, Р.Ф. Курунов, С.С. Поликарпов, С.В. Фролов «Мощные твердотельные лазеры на Nd:YAG с поперечной накачкой и улучшеным качеством излучения», *Журнал технической физики*, 2011, 81, № 8, стр. 70-75
- 3. W.F. Krupke *Diode Pumped Alkali Laser*, U.S. Patent № 6643311 B2 (2003).
- 4. S. Jacobs, G. Gould, P. Rabinowitz, *Physical Review Letters* 7 (11) (1961) 415.
- 5. P. Rabinowitz, S. Jacobs, G. Gould, Applied Optics 1 (4) (1962) 513.
- Б.А. Глушко, М.Е. Мовсесян, Т.О. Овакимян Оптика и спектроскопия, 52, 458, 1982.
- 7. С.Н. Атутов, А.И. Плеханов, А.М. Шалагин Оптика и спектроскопия, **56**, 134, 1984.
- 8. А.М. Шалагин Мощные лазеры на парах щелочных металлов с диодной накачкой, УФН, 181, №9, 1011-1016, 2011.
- 9. J. Zweibak, B. Krupke, A. Komashko, Pocieeding of SPIE 687413 (2008).
- 10.Raymond J. Beach, William F. Krupke, V. Keith Kanz, Stephen A. Payne, Mark A. Dubinskii, Larry D. Merkle, *End-pumped continuous-wave alkali vapor lasers: experiment, model, and power scaling*, J.O.S.A. B, **21**, №12, 2004.
- 11.А.В.Богачев, С.Г.Гаранин, А.М.Дудов, В.А.Ерошенко, С.М.Куликов, Г.Т.Микаелян, В.А.Панарин, В.О.Паутов, А.В.Рус, С.А.Сухарев, Лазер на парах цезия с диодной накачкой и прокачкой лазерной среды по замкнутому циклу, «Квантовая электроника», 42, № 2 (2012), стр. 95-98.

Приложение

В приложении представлена информация о технических характеристиках одиночных мощных лазерных диодов, линейки лазерных диодов и матрицы лазерных диодов. Все данные процитированы с вебсайтов производителей.

Компания «Полупроводниковые приборы».

Сайт: http://www.atcsd.ru/rus/cont.php



		· · ·					
<u>ATC-</u> <u>C500-200</u>	<u>ATC-</u> <u>C1000-380</u>	<u>ATC-</u> <u>C1000-100</u>	<u>ATC-</u> <u>C2000-200</u>	<u>ATC-</u> <u>C2000-100</u>	<u>ATC-</u> <u>C4000-200</u>	<u>ATC-</u> <u>C5000-200</u>	
Выходная оптическая мощность в непрерывном режиме (мВт)							
500	1000	1000	2000	2000	4000	5000	
	•	Размеры излу	/чающей плоц	цадки WxH(мк	м)		
200x1	380x1	100x1	200x1	100x1	200x1	200x1	
		Возмо	жные длины в	волн (нм)			
660)-670		79	5-815 или 940	-980		
		Г	Іороговый ток	: (A)			
0.7	1.3	0.25	0.5	0.6	0.5	0.5	
Типичный рабочий ток (А)							
1.35	3.0	1.3	2.5	2.3	4.3	5.3	
		Максим	альный рабоч	ий ток (А)			
1.5	3.2	1.5	3.0	2.5	5.0	6.0	
		Максималы	юе рабочее н	апряжение (В)		
-	2.0	2.2	2.4	2.2	2.4	2.2	
	E	возможный ти	п корпуса <u>С-п</u>	nount, <u>ATC</u> , <u>T</u>	<u>0-3</u>		
ATC-	ATC-C8000-200 ATC-C10000-200 ATC-C15000-400				<u>00-400</u>		
Выходная оптическая мощность в непрерывном режиме (мВт)							
8000	3000 10000 15000)0		
Размеры излучающей площадки WxH(мкм)							
200x1 400x1						_	
	Возможные длины волн (нм)						

Спецификация на лазерные диоды

	805-811				
Пороговый ток (А)					
0.85	1.9	2.4			
Типичный рабочий ток (А)					
8.5	12.0	16.0			
Максимальный рабочий ток (А)					
9.0	14.0	17.0			
Максимальное рабочее напряжение (В)					
2.1 2.2					
Возможный тип корпуса <u>C-mount</u> , <u>ATC</u> , <u>TO-3</u>					



Лазерные диоды модели АТС-С4000-200



Спецификация

	05.000	Величина			Ед.
Параметр (Т _{оР} =25 ^о С)	ие	Мин.	Норм.	Макс.	измерен ия
Выходная мощность (непрерывный режим) ¹⁾	Pcw		4,0		Вт
Длина волны излучения ²⁾	λ	804	807	810	НМ
Ширина спектра (FWHM) ²⁾	Δλ		3		НМ
Дифф. квантовая эффективность	η _D	0.9	1.05	1.2	Bt/A
Размер тела свечения	W x H		200 x 1.0		МКМ
Пороговый ток	I _{TH}	0.8	1.0	1.2	А
Рабочий ток ¹⁾²⁾	I _{OP}		4.5	5.2	Α
Рабочее напряжение ¹⁾²⁾	U _{OP}		1.9	2.1	В
Дифф. сопротивление	Rs		0.05	0.10	Ом
Расходимость (FWHM)	$\Theta_{ } x \Theta_{\perp}$		6x35	10x40	Град.
Темп коэффициент порогового тока ³⁾	To		220		К
Темп. коэффициент рабочего тока	I _{OP2} /I _{OP1} T		0.2		%/K
Темп. коэффициент длины волны излучения	$\Delta\lambda/\Delta T$		0.27	0.3	нм/К
Термическое сопротивление	R _T		6		K/BT

Максимальные значения

Выходная мощность (непрерывный режим) ¹⁾	Pcw		 4,8	Вт
Обратное напряжение	U _R		 2	В
Рабочая температура (для герметизированного корпуса)	T _{OP}	- 10	 + 50	٥C
Температура хранения (для герметизированного корпуса)	Т _{st}	- 40	 + 60	٥C
Температура пайки выводов (время пайки 5 сек)	Τ _s		 250	٥C

сбор излучения осуществляется оптической системой с числовой апертурой 0.75
Указанное значение соответствует выходной мощности 4 Вт в непрерывном режиме

³⁾ Темп коэффициент порогового тока может быть вычислен по формуле: I_{TH2}=I_{TH1}exp[(T₂-T₁)/T0]

Northrop Grumman Corporation

Сайт: http://www.northropgrumman.com



LASER DIODE BARS

200W QCW

NORTHROP GRUMMAN

Basedon	
rarameter	Conditions
Heverse Curtent	0A
Reverse vonage	0 V 40/2 to 70/2
Operating temperature mange	-40 C to 70 C
sionige remperature Hange	146-6 10 80 G
DERING CHARACTERISTICS	
V. Stewarter	Conditions
Metalization	2000 Å August Pt barriet
PV91amaat/JU11	NOO A AD OVER 11 DEFINE
ICAL CHARACTERISTICS (TYPICAL)	
Power vs. Current	Wavelength Spectrum
300	
- 20	
1 18	"i j / /
100	1 / /
	** / \
8 80 990 991 200	38
Counter (#)	and BOB Manufacture Inc.
CHANICAL CHARACTERISTICS	
	p-side
THICKNESS	10.135 µm
FAST AXIS	
CAVITY LENGTH CAVITY WIDTH	
LONGTTUDTINAL SLOW AX15	9.6mm
	a-side
×	
20	A A A
T Martin	A CONTRACT OF A
X	

Copyright © 2008 Northrup Gnimman Cutting Edgli Optimice AF Rybe. Reserved, Northrup Gnimman Cutting Edge Optimice reserve: this right to change product design and specifications in any time without notice. No locanse is granted by implication or otherwise under any patients or patient rights of Northrup Cutting Edge Optimics in any time without notice. No locanse is granted by implication or otherwise under any patients or other in the lights of othern resulting from the use of these products. Information contained herein is believed to be relative and accurate, Laser dode products. Components of othern resulting from the use of these products. Information contained herein is believed to be relative and accurate, Laser dode products. Information contained herein is believed to be relative and accurate, Laser dode products. Components of othern resulting from the use of these products. Information contained herein is believed to be relative and accurate, Laser dode products. Components during their operation. Only process and any other, Noverver, these products are patient of the board patients of the beam or exposure to specialize influences and thereities evolutions and any negative fit the board patients with the expectation in any may result if any patient of the board. The beam or exposure to specialize influences and thereities, proper evidence in the products may increase even haard. Always were proper every protection with the appropriate resolution should be not an at there (See 01) the board matter (See 01) (See 01)



				GNORMAL
		1	PART NUN	IBER: ASM232C040
FEATURES AND BENEFITS	111		GOLULII DUL	LET GODMODULE
t on anno an Mathematica ann an 1970.			- Proprietary I	iard Solder Technology
	111	11	- Long Pulso	and/or High Duty Curle
	///		Lung i ulde i	ion Matched Meterial
	LL I	1	- Expans	aud Matcheo Materials
		1		Available Wavelengths (790-980nm)
				trans Section
	-			
OPTICAL CHARACTERISTICS				
				and
CW Power Output	50A at 25°C Heat Sink	Min 40	Ivp	W
Operating Current	40W at 25°C Heat Sink	40	50	A
Threshold Current	25°C Heat Sink		13	A
Center Wavelength	40W at 25°C Heat Sink		808	nm
Wavelength Tolerance	40W at 25°C Heat Sink	77	+/-3	nm
Spectral Width	40W at 25°C Heat Sink		1.6	nm
Beam Divergence FWHM	-2	1 1 1 1 1 1	40x10	'x'
ELECTRICAL CHARACTERISTICS				
Parameter	Conditions	Min	Тур	Units
Series Resistance	25°C Heat Sink		0.002	ohms
Operating voltage	25 C Heat Sink, 40W	5.77	1.8	a.
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS				
Parameter		Conditions		
Reverse Current		0 A		
Reverse Voltage		OV		
Operating Temperature Range		-40°C to 70°C		
Storage Temperature Range		-40°C to 85°C		
NOTEC				
NUIES				
(1) These specifications apply for operation at (308nm. Other wavelengths available upon rece	Jest.		



Cutting Edge Optronics 20 Point West Blvd. St. Charles, M0 63301 P 636.916.4900 F 636.916.4994 www.st.northropgrumman.com/ceolaser st-ceolaser-info@ngc.com

ОАО «Научно-производственное предприятие «Инжект»

Сайт: http://www.inject-laser.ru/



работы

тип 32ДЛ-503

Свойства:

1300Bт/см²

100мДж

решетка

охладитель

Монолитная

многослойная

Плотность оптической выходной мощности до

лазерного излучения до

двухмерная наборная

Встроенный термистор

и термоэлектрический

Энергия импульса

Области применения:

- Эффективная оптическая накачка лазерных стержней или пластин высоко-мощных твердотельных лазеров
- Лазерные системы для технологических применений
- ИК лазерные осветители с высокой оптической выходной мощностью
- Лазерные медицинские системы

Параметр	Значения	Единицы
Выходная мощность излучения	250	Вт
Длина волны излучения	от 808±3	НМ
Ширина огибающей спектра лазерного излучения по уровню 0,5 от максимума	<4,0	НМ
Длительность оптического импульса до	0,4	мс
Частота повторения импульсов до	20	Гц
Размер излучающей области	2x9,5	MM ²
Количество линеек в одной матрице	19	ШТ
Расстояние между линейками ЛД	0,5	MM
Расходимость излучения (ширина полосы по уровню 0,5 от максимума относительно плоскости p-n перехода)	θ _{парал} < 10 θ _{перп} < 35	град
Падение напряжения, не более	60	В
Ток накачки, не более	16	Α
Сопротивление термистора при 20°С	10 (20%)	кОм
Температурный коэффициент сопротивления термистора	-3,64,0	%/°C
Рабочий ресурс	10⁹	импульс
Внешние габариты	12(Ш)х12(Д)х10(В)	ММ